

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2025-070



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请

获上交所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司以全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”）为出资主体与专业机构合资成立的私募股权投资基金——苏州璞云创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州璞云”）投资的盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation，以下简称“盛合晶微”）首次公开发行股票并在科创板上市申请于 2025 年 10 月 30 日获上海证券交易所受理。

盛合晶微《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》显示：盛合晶微是全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业，起步于先进的 12 英寸中段硅片加工，并进一步提供晶圆级封装（WLP）和芯粒多芯片集成封装等全流程的先进封测服务，致力于支持各类高性能芯片，尤其是图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）、人工智能芯片等，通过超越摩尔定律（More than Moore）的异构集成方式，实现高算力、高带宽、低功耗等的全面性能提升。

宁波上融作为有限合伙人出资 15,000 万元持有苏州璞云 67.72% 的投资份额（具体内容请详见 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展公告》（公告编号：2023-013）。截至本公告日，苏州璞云持有盛合晶微 17,454,646 股（本次发行前），持股比例为 1.086%。

盛合晶微本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，能否获得前述批准或核准、

最终获得前述批准或核准时间、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日